DERWENT-ACC-NO:

1986-276107

DERWENT-WEEK:

198642

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Standard particle

adhering equipment for mfg. standard

wafer - has standard

particle generator, particle counter

and dispersing plate

including many cone-shaped holes

NoAbstract Dwg 1/3

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0043908 (March 6,

1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 61202139 A

N/A

005

September 6, 1986 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 61202139A

N/A

1985JP-0043908

March 6, 1985

INT-CL (IPC): G01N001/00, H01L021/66

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-F01A;

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 202139

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月6日

G 01 N 1/00 H 01 L 21/66 1 0 2 B-7005-2G 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

標準粒子付着装置

②特 願 昭60-43908

砂出 願 昭60(1985)3月6日

砂発 明 者

平塚 八郎

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝 川崎

川崎市幸区堀川町72番地

明 相 🖀

1. 発明の名称

標準、粒子付着装置

2. 特許請求の範囲

(1) 単分散した標準粒子を発生させる標準粒子発生部と、この標準粒子発生部に於いて発生した標準粒子の粒径及び粒子数を測定する標準粒子的記標準粒子発生部で発生した標準粒子付着させる標準粒子付着装配とを具備したことを特徴とする標準粒子付着装置。

② 前記標準粒子発生部は、液状の標準粒子を 器状に吹出すアトマイザと、このアトマイザによ り吹出された標準粒子を乾燥させ単分散させる手 段とからなる特許請求の範囲第1項記載の標準粒 子付着装置。

(3) 前記標準粒子付着部は、前記試料が収納される容器と、同心円上に逆円錐形の鉱散孔が多数設けられ、前記 器の前記試料上に設置される標準粒子拡散板とからなる特許請求の範囲第1項又

は第2項いずれか記載の標準粒子付着装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は標準粒子付着装置に係り、特にレーザ散乱光を応用したウェハ表面付着微粒子数計別装置に於ける較正用標準ウェハの作成に使用される標準粒子付着装置に関する。

[発明の技術的背景及びその問題点]

半導体デバイスの機能化に伴い、シリコンウエハの表面に付着した微粒子がデバイス特性に与える影響は増々大きくなってきつつある。そして、このウエハ表面に付着したサブミクロン微粒子の計数装置もユーザの要求に応じて開発が進められ、そのうちの数機種が市販されている。

それらの殆どは、走査部の駆動によりウェハの表面をHe‐Neレーザピームで走査し、ウェハ表面付着微粒子からの散乱光を検出し、検出信号により微粒子数、位置、分布を出力部に表示するような機構となっている。

微粒子粒径の検出や粒径検出感度の較正は、電

- 1 -

気的な関整のみでも可能であるが、信頼性が低い。 また、ラテックス標準粒子をウェハ表面に付着 させて標準ウェハとして使用すると良いが、均一 に数粒子を付着させる技術はまだ未熟である。

サプミクロンの粒径を有するラテックス概準粒子をウエハ表面に付着させて、微粒子計数装置の 較正用標準ウエハとして使用するためには、単分 散した機準粒子がウエハ表面に均一に分布して付 着していなければならない。

従来技術としては、標準粒子希釈液をアトマイザでウェハ表面に吹付け付着させる方法や、希釈 液をウェハ表面に落下後ウェハを高速回転させて・ 付着させる方法等がある。

しかしながら、上記いずれの方法に於いても、 標準粒子を単分散させることや、標準粒子をウエ ハ表面に均一に付替させることは不可能であり、 従来の方法では較正用として使用可能な標準ウエ ハを作成することができなかった。

[発明の目的]

本発明は上記実情に鑑みてなされたもので、そ - 3 -

する。本実施例に於いては、本発明による装置を使用して 0.5 μの粒怪を有するラテックス 標準粒子を単分散させ、ウエハ表面に均一に分散させて、ウエハ表面微粒子計数装置の較正用標準ウエハを作成した例について説明する。

の目的は、一定の粒径の標準粒子を単分散させた状態で試料の表面に一定密度で均一に付着させることのできる標準粒子付着装置を提供することに

[発明の概要]

本発明に係る標準粒子付着装置は、単分散した概単粒子を発生させる標準粒子発生部と、この標準粒子発生部に於いて発生した標準粒子の粒径及び粒子散を測定する標準粒子が設定部と、前記標準粒子発生部で発生した標準粒子を試料表面に均一に分散付着させる標準粒子付着部とを備えている。

上記標準粒子発生部に於いては、被状の標準粒子が繋状に吹出され、この標準粒子は乾燥空気で単分散される。この乾燥空気で単分散された概率粒子付着部に於いて、同心円上に逆円錐形の拡散孔を多数有する標準粒子拡散を通過することにより均一濃度で拡散され、上記試料の表面に均一密度で付着する。

「発明の実施例]

以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明

標準粒子測定部 12に於いては、ダストカウンタ 33により流入した乾燥空気中の標準粒子の粒径と 粒径分布が計測されるようになっている。

すなわち、前記装置に於いては、根準粒子発生 部11に於いて、ダイヤフラムポンプ21により空気 を取り入れ、水冷トラップ22、水セパレータ23、 ドライヤ24、25を通過させることにより空気中の 水分を取り除き、この乾燥空気をアトマイザ29内 を過過させる。アトマイザ29から吹出されたラテックス標準粒子は乾燥空気の通過により単分散し、 エアロゾル混合管32内に導かれる。エアロゾル混合管32内に導かれる。エアロゾル混合管32内に導かれる。エアロゾル混合管32内に導かれる。エアロゾル混合管32内に導かれる。エアロゾル混合管32内に導かれる。

銀準粒子測定部 12に於いては、ダストカウンタ33により流入した乾燥空気中の標準粒子の粒径と粒径分布が計測される。一方、概準粒子付着部 13に流入した乾燥空気中の 標準粒子はウエハ容器 34内に場かれ、標準粒子拡散板 35の拡散 孔 38… は前述のように周心円上に設けられ、かつ逆円錐形に形成されているため、標準粒子は均一濃度で拡散し、シリコンウエハ 36の表面に均一な密度で付着する。こ

•

地粒子を単分散させた状態で、試料の表面に一定 密度で均一に付替させることのできる標準粒子付 替装置を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例に係る概堪粒子付着 装置を示す構成図、第2 図は第1 図の装置に於けるウェハ容器の構成を示す断面図、第3 図は標準粒子の分布状態を従来方法と本発明の方法を比較 して示す図である。

11… 複単粒子発生部、 12… 模単粒子測定部、 13 … 標準粒子付着部、 21… ダイヤフラムポンプ、 24、 25… ドライヤ、 29… アトマイザ、 29 a … 希釈液、 32… エアロゾル混合管、 33… ダストカンウタ、 34 … ウェハ容器、 35… 標準粒子拡散板、 36… シリコンウェハ、 38… 拡散孔。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

のシリコンウェハ36の表面に付着した機準粒子の数と大きさはダストカウンタ33の計剤値により換算できるものである。従って、このシリコンウエハ36は較正用標準ウエハとして使用することが可能となる。

尚、上記実施例に於いては、本発明を較正用標準ウエハ作成装置に適用した例について説明したが、これに限定するものではなく、その他一般に一定の粒径の粒子を試料表面に均一に分散付着させる必要のある装置に適用できるものである。 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、一定の粒径の復 - 8 -



